

Title (en)

Floor covering to cover dismountable floor panels, floor construction with floor covering and its method of manufacture

Title (de)

Bodenbelag für die Abdeckung von demontierbaren Bodenplatten, Bodenkonstruktion mit Bodenbelag und Verfahren zur Herstellung des Bodenbelags

Title (fr)

Revêtement de sol pour le recouvrement de panneaux de planchers démontables, structure de sols avec revêtement de sol et son procédé de production

Publication

**EP 1234928 A2 20020828 (DE)**

Application

**EP 02004548 A 20020227**

Priority

- DE 10109389 A 20010227
- US 25476202 A 20020926

Abstract (en)

Floor covering (6) for covering removable floor tiles (1), especially false floors, comprises a ventilated, conductive fixing adhesive (2) uniformly applied on the underside and protected from drying out on the outside by a covering film. Independent claims are also included for a floor construction comprising the above floor covering and for a process for producing the above floor covering. Preferred Features: The fixing adhesive is an acrylate dispersion with an electroconductive additive. The floor covering is designed as a roll of floor tiles.

Abstract (de)

Beschrieben wird ein Bodenbelag (6) für die Abdeckung von demontierbaren Bodenplatten (1), insbesondere von Doppelböden. Zur Minimierung des Verlegeaufwands ist auf den Bodenbelag (6) unterseitig ein verlegungsbereit abgelüfteter, leitfähiger Fixierkleber (2) gleichmässig aufgetragen, welcher mit einer Abdeckfolie (7) nach aussen gegen Austrocknung geschützt ist. <IMAGE>

IPC 1-7

**E04F 15/024**; **E04F 15/02**

IPC 8 full level

**E04F 15/02** (2006.01); **E04F 15/024** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**E04F 15/02** (2013.01 - EP US); **E04F 15/024** (2013.01 - EP US); **E04F 15/02405** (2013.01 - EP US)

Cited by

US9868862B2

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE GB LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 1234928 A2 20020828**; **EP 1234928 A3 20030226**; DE 10109389 A1 20020905; US 2004060254 A1 20040401

DOCDB simple family (application)

**EP 02004548 A 20020227**; DE 10109389 A 20010227; US 25476202 A 20020926